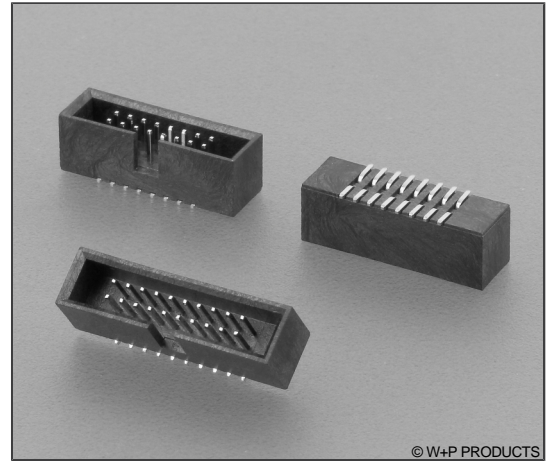


Technische Daten / Technical Data

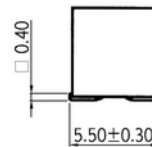
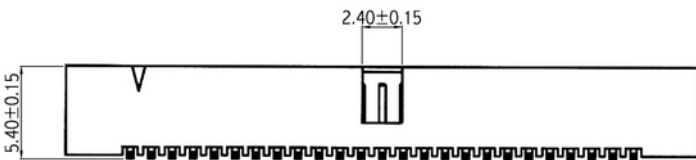
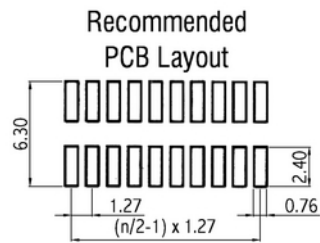
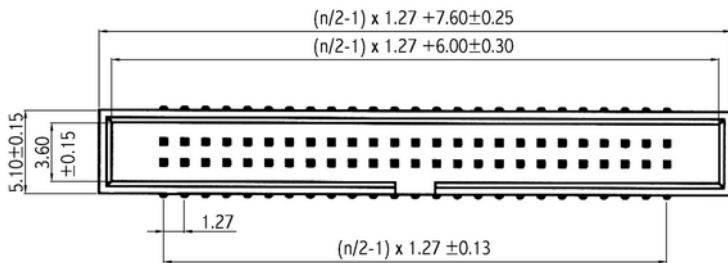
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Messing
<i>Contact Material</i>	<i>Brass</i>
Kontaktoberfläche	Vergoldet
<i>Contact Surface</i>	<i>Gold plated</i>
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
<i>Solderability</i>	<i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
<i>Test Voltage</i>	<i>500V_{AC}</i>
Nennstrom	1A
<i>Current Rating</i>	<i>1A</i>
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

376



Series

3360

Contacts*

016

010-100

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Packaging*

ST

ST
PPST
PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

